

北京君正集成电路股份有限公司

2020 年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日

2、预计的业绩：同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：92.94%—61.98%	盈利：3,696.18 万元
	盈利：约 261.11 万元—1,405.29 万元	

二、 业绩预告预审计情况

公司 2020 年半年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、 业绩变动原因说明

报告期内，受疫情影响，公司微处理器芯片与智能视频芯片的收入总体略有下降，其中微处理器芯片销售收入同比下降，智能视频芯片销售收入保持增长；同时，2020 年 5 月公司完成对北京矽成的收购，自 2020 年 6 月起公司对北京矽成实现并表，从而使公司总体营业收入较去年同比增长。

由于本次收购产生存货、固定资产和无形资产等的评估增值，2020 年 6 月当月新增资产摊销部分致营业成本和经营费用同比增长，从而使公司净利润大幅下降。

报告期内，公司非经常损益约 2,200 万元，去年同期 2,456.58 万元。

综合上述等因素，预计 2020 年半年度归属于上市公司股东的净利润同比下降。

四、 其他相关说明

2020 年上半年，全球范围内陆续爆发了新冠疫情，在这一全球性不可抗力因素的影响下，北京矽成在中国和海外的市场先后受到不同程度的影响，尤其在

汽车电子市场，客户工厂停工、市场需求下降等导致出现较多的订单取消或延期情况。

目前全球新冠疫情仍较为严重，尤其在欧美地区。由于欧美市场是北京矽成在汽车电子领域的重要市场，尽管部分地区陆续开始谨慎复工，但仍无法确定北京矽成 2020 年度经营情况受疫情的影响程度，如汽车电子市场无法得到快速回暖，北京矽成将面临无法完成业绩承诺的风险。

本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2020 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十五日